

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

**截至2026年6月30日止6個月之
中期業績公告**

本集團的財務摘要

本集團截至2026年6月30日止6個月之未經審計中期業績連同截至2025年6月30日止6個月之比較數字如下：

	截至6月30日止6個月		變動
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (經審計)	
收入	2,540,419	1,523,665	66.7%
毛利	743,215	500,672	48.4%
經營溢利／(虧損)	75,803	(75,882)	不適用
期內溢利／(虧損)	65,063	(78,010)	不適用
期內全面收益總額	63,863	(75,586)	不適用
每股收益／(虧損)			
－基本及攤薄(人民幣元)	0.42	(0.55)	不適用

本期業績

蘇州納芯微電子股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」及其附屬公司「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈本集團截至2026年6月30日止6個月之報告期未經審計簡明綜合中期業績，連同截至2025年6月30日止6個月的比較數字。

合併財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債及以公允價值計量的衍生金融工具除外。

財務資料

以下載列於本公告內的未經審計簡明綜合中期財務資料已由審計委員會審閱，並經董事會批准和獲本公司的境外核數師－畢馬威會計師事務所按香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」審閱。

綜合損益表

截至2026年6月30日止6個月

	附註	截至6月30日止6個月	
		2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (經審計)
收入	3	2,540,419	1,523,665
銷售成本		<u>(1,797,204)</u>	<u>(1,022,993)</u>
毛利		<u>743,215</u>	<u>500,672</u>
其他淨收入		110,121	41,680
銷售及營銷開支		(140,621)	(109,975)
管理開支		(174,426)	(143,234)
研發開支		(446,329)	(361,282)
貿易及其他應收款項減值虧損		<u>(16,157)</u>	<u>(3,743)</u>
經營溢利／(虧損)		75,803	(75,882)
財務成本	4	(12,841)	(11,328)
應佔聯營公司及合營企業減值虧損及撥備		<u>(148)</u>	<u>(2,392)</u>
除稅前溢利／(虧損)		62,814	(89,602)
所得稅	5	<u>2,249</u>	<u>11,592</u>
期內溢利／(虧損)		<u>65,063</u>	<u>(78,010)</u>
以下各項應佔：			
本公司權益股東		67,591	(78,010)
非控股權益		<u>(2,528)</u>	<u>—</u>
期內溢利／(虧損)		<u>65,063</u>	<u>(78,010)</u>
每股收益／(虧損)			
基本及攤薄(人民幣元)	6	<u>0.42</u>	<u>(0.55)</u>

綜合損益及其他全面收益表
截至2026年6月30日止6個月

	截至6月30日止6個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(經審計)
期內溢利／(虧損)	65,063	(78,010)
期內其他全面收益		
換算匯兌差額：		
－海外附屬公司財務報表	(1,200)	2,424
期內全面收益總額	63,863	(75,586)
以下各項應佔：		
本公司權益股東	66,391	(75,586)
非控股權益	(2,528)	—
期內全面收益總額	63,863	(75,586)

綜合財務狀況表

於2026年6月30日

	附註	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
非流動資產			
物業、廠房及設備		2,021,280	1,837,365
使用權資產		26,744	21,892
無形資產		358,731	389,174
商譽		545,470	545,470
於聯營公司及合營企業的權益		298,475	111,052
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		569,396	428,971
定期存款		81,851	81,038
其他非流動資產		592,740	45,858
遞延稅項資產		88,785	43,102
		<u>4,583,472</u>	<u>3,503,922</u>
流動資產			
存貨及合約成本	7	1,657,931	1,475,940
合約資產		285	285
貿易及其他應收款項	8	1,231,555	995,907
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		681,597	1,124,163
定期存款		55,000	93,000
受限制銀行存款		1,821	22,656
現金及現金等價物		2,301,149	2,465,627
		<u>5,929,338</u>	<u>6,177,578</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	880,059	840,416
合約負債		37,103	33,191
計息借款		189,870	115,537
租賃負債		10,934	8,685
即期稅項		1,135	742
退回權利的退款負債		55,013	53,355
		<u>1,174,114</u>	<u>1,051,926</u>

綜合財務狀況表(續)

於2026年6月30日

	附註	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
流動資產淨值		<u>4,755,224</u>	<u>5,125,652</u>
總資產減流動負債		<u>9,338,696</u>	<u>8,629,574</u>
非流動負債			
計息借款		1,391,401	851,512
租賃負債		14,549	10,891
就收購附屬公司應付款項		17,489	17,489
遞延收入		37,688	40,081
遞延稅項負債		75,057	54,684
退回權利的退款負債		7,562	6,918
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		<u>33,685</u>	<u>33,236</u>
		<u>1,577,431</u>	<u>1,014,811</u>
淨資產		<u>7,761,265</u>	<u>7,614,763</u>
資本及儲備			
股本		162,623	161,597
庫存股份		(215,010)	(127,664)
儲備		<u>7,794,998</u>	<u>7,563,249</u>
本公司權益股東應佔權益總額		7,742,611	7,597,182
非控股權益		<u>18,654</u>	<u>17,581</u>
權益總額		<u>7,761,265</u>	<u>7,614,763</u>

附註

截至2026年6月30日止6個月

1. 一般資料

蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於2013年5月17日在中華人民共和國(「中國」)江蘇省蘇州市根據中國公司法成立為有限責任公司。

於2016年3月，本公司改制為股份有限公司。於2022年4月，本公司的A股於上海證券交易所科創板上市，股份代號：688052。本公司H股於2025年12月8日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事設計、研究及開發各類芯片產品。

2. 會計政策概述

2.1 財務報告編製基礎

本中期財務報告乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定編製，包括遵照國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」。本報告於2026年8月27日獲准發佈。

編製本中期財務報告所採用的會計政策與2025年度財務報表所採用者相同，惟預期將於2026年度財務報表中反映的會計政策變動則除外。任何會計政策變動詳情載於附註2.2。

遵照國際會計準則第34號編製中期財務報告，規定管理層作出影響政策應用及年初至今的資產與負債、收入及開支呈報金額的判斷、估計及假設。實際結果可能與此等估計有所不同。

本中期財務報告載有簡明綜合財務報表及經篩選的解釋附註。該等附註載有多項事件及交易的說明，對瞭解本集團自2025年度財務報表以來財務狀況的變動及表現十分重要。簡明綜合中期財務報表及其附註並未載有根據國際財務報告會計準則編製整份財務報表所需的全部資料。

本中期財務報告未經審核，但已由畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。

2.2 會計政策變更

國際會計準則理事會頒佈了多項於本會計期間首次生效的國際財務報告會計準則修訂本。該等發展對本財務報表概無產生重大影響。本集團並未應用任何於本會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

3. 收入

按主要產品或服務劃分的客戶合約收入拆分如下：

	截至6月30日止6個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (經審計)
國際財務報告準則第15號範圍內的客戶合約收入		
按主要產品或服務線拆分		
－傳感器產品	642,813	413,028
－信號鏈芯片	1,011,287	585,789
－電源管理芯片	879,326	519,443
－其他	6,993	5,405
	<u>2,540,419</u>	<u>1,523,665</u>

按收入確認時間劃分的客戶合約收入明細如下：

	截至6月30日止6個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (經審計)
按收入確認時間分類		
時間點	2,537,138	1,520,731
隨時間	<u>3,281</u>	<u>2,934</u>
	<u>2,540,419</u>	<u>1,523,665</u>

4. 除稅前溢利／(虧損)

除稅前溢利／(虧損)已扣除下列各項：

		截至6月30日止6個月	
		2026年	2025年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審計)	(經審計)
(a) 財務成本			
以下項目的利息			
– 貸款	12,472	11,010	
– 租賃負債	369	318	
	<u>12,841</u>	<u>11,328</u>	
		截至6月30日止6個月	
		2026年	2025年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審計)	(經審計)
(b) 其他項目			
折舊費用			
– 自有物業、廠房及設備	108,942	83,412	
– 使用權資產	5,008	5,019	
	<u>113,950</u>	<u>88,431</u>	
無形資產攤銷成本		<u>32,670</u>	<u>28,572</u>
研發開支		<u>446,329</u>	<u>361,282</u>
存貨成本		<u>1,797,204</u>	<u>1,022,993</u>

5. 所得稅

綜合損益表中的稅項指：

	截至6月30日止6個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(經審計)
即期稅項		
期內撥備	<u>1,768</u>	<u>2,116</u>
遞延稅項		
暫時差額的產生及撥回	<u>(4,017)</u>	<u>(13,708)</u>
	<u>(2,249)</u>	<u>(11,592)</u>

6. 每股收益／(虧損)

(a) 每股基本收益／(虧損)

每股基本收益／(虧損)乃根據本公司普通權益股東應佔盈利人民幣67,591,000元(截至2025年6月30日止6個月：本公司普通權益股東應佔虧損人民幣78,010,000元)及期內已發行普通股加權平均數160,860,000股(截至2025年6月30日止6個月：142,411,000股)計算。

(b) 每股攤薄收益／(虧損)

截至2026年6月30日止6個月期間，每股攤薄收益的計算基於本公司普通權益股東應佔利潤人民幣67,591,000元，以及普通股加權平均數162,565,000股。

截至2025年6月30日止6個月期間，限制性股份不計入每股攤薄虧損的計算，因為將會產生反攤薄影響。因此，每股攤薄虧損的金額與每股基本虧損的金額相同。

7. 存貨及合約成本

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
存貨		
芯片產品		
– 原材料	386,181	364,662
– 在製品	711,740	553,605
– 製成品	513,156	515,879
– 在途物資	9,637	14,695
– 交付予客戶的貨物	15,296	9,632
	<u>1,636,010</u>	<u>1,458,473</u>
合約成本	<u>21,921</u>	<u>17,467</u>
	<u>1,657,931</u>	<u>1,475,940</u>

8. 貿易及其他應收款項

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
貿易應收款項	928,062	636,738
應收票據	<u>14,245</u>	<u>15,765</u>
貿易應收款項及應收票據	<u>942,307</u>	<u>652,503</u>
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 應收票據	<u>17,092</u>	<u>31,991</u>
其他應收款項	30,643	30,694
產能保證金	49,098	110,750
可收回增值稅	24,813	40,583
預付款項	129,292	92,960
其他	<u>38,310</u>	<u>36,426</u>
	<u>1,231,555</u>	<u>995,907</u>

截至報告期末，貿易應收款項及應收票據按到期日及扣除虧損撥備後的賬齡分析如下：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
1年內	942,206	652,492
超過1年但少於2年	101	3
超過2年但少於3年	—	8
	<u>942,307</u>	<u>652,503</u>

9. 貿易及其他應付款項

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
貿易應付款項	539,446	461,838
應付票據	—	5,000
應計工資	162,609	317,039
對聯營公司的投資應付款項	60,000	—
限制性股票激勵計劃的認購款項	59,963	—
其他應付稅項及附加費	29,886	15,174
其他應付款項	10,666	3,817
收購附屬公司的應付款項	17,489	37,548
	<u>880,059</u>	<u>840,416</u>

截至報告期末，貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
1年內	519,049	448,086
超過1年但少於2年	18,221	12,329
超過2年但少於3年	959	520
超過3年	1,217	903
	<u>539,446</u>	<u>461,838</u>

10. 股息

本公司及其任何附屬公司於報告期內並無派發或宣派股息。

財務回顧

收入

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月按業務劃分的收入的絕對金額和佔收入的百分比：

	截至6月30日止六個月				變動
	2026年		2025年		
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
	(未經審計)		(經審計)		
傳感器產品	642,813	25.3%	413,028	27.1%	55.6%
信號鏈芯片	1,011,287	39.8%	585,789	38.4%	72.6%
電源管理芯片	879,326	34.6%	519,443	34.1%	69.3%
其他 ⁽¹⁾	6,993	0.3%	5,405	0.4%	29.4%
總計	2,540,419	100.0%	1,523,665	100.0%	66.7%

附註：

(1) 主要包括我們的定製服務及配套組件銷售收入。

截至2026年6月30日止6個月本公司實現收入人民幣2,540.4百萬元，同比增長66.7%，其中傳感器產品實現收入人民幣642.8百萬元，同比增長55.6%；信號鏈芯片實現收入人民幣1,011.3百萬元，同比增長72.6%；電源管理芯片實現收入人民幣879.3百萬元，同比增長69.3%；其他業務實現收入人民幣7.0百萬元，同比增長29.4%。

分業務來看，傳感器產品實現收入人民幣642.8百萬元，同比增長55.6%，主要由於公司已形成覆蓋多行業、多精度等級的傳感器產品組合，滿足從消費級到高可靠應用的多層次需求，實現銷售快速增長；信號鏈芯片實現收入人民幣1,011.3百萬元，同比增長72.6%，主要由於下游汽車電子、工業自動化等領域客戶需求大幅增長；電源管理芯片實現收入人民幣879.3百萬元，同比增長69.3%，主要由於公司電源管理產品矩陣不斷豐富，國內外市場拓展持續推進，銷售額同比有較大的提升。

毛利及毛利率

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月按業務劃分的毛利絕對金額和毛利率：

	截至6月30日止六個月		變動
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (經審計)	
存貨減值虧損前金額			
傳感器產品	256,039	191,768	33.5%
信號鏈芯片	327,071	204,781	59.7%
電源管理芯片	210,885	120,906	74.4%
其他 ⁽¹⁾	4,732	3,460	36.8%
小計	798,727	520,915	53.3%
存貨減值虧損	(55,512)	(20,243)	
毛利	743,215	500,672	48.4%
毛利率	29.3%	32.9%	

附註：

(1) 主要包括我們的定製服務及配套組件銷售收入。

截至2026年6月30日止6個月本公司毛利率29.3%，同比下降3.6個百分點，整體毛利率相對穩定，報告期內毛利率下降主要由於公司材料成本受上游供應商原材料價格上漲影響，材料成本金額增長較快所致。

銷售及營銷開支

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月銷售及營銷開支的金額及佔收入的比重：

	截至6月30日止六個月				
	2026年		2025年		變動
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
	(未經審計)		(經審計)		
銷售及營銷開支	<u>140,621</u>	<u>5.5%</u>	<u>109,975</u>	<u>7.2%</u>	<u>27.9%</u>

截至2026年6月30日止6個月本公司銷售及營銷開支人民幣140.6百萬元，同比增長27.9%，銷售及營銷開支費用率5.5%，同比下降1.7個百分點，主要由於公司持續在市場開拓、人才建設等多方面資源投入使得本期銷售費用中的職工薪酬較上年同期增加，整體銷售費用有所增長，但增長比例小於營收增長比例。

管理費用

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月的管理費用的金額及佔收入的比重：

	截至6月30日止六個月				
	2026年		2025年		變動
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
	(未經審計)		(經審計)		
管理費用	<u>174,426</u>	<u>6.9%</u>	<u>143,234</u>	<u>9.4%</u>	<u>21.8%</u>

截至2026年6月30日止6個月本公司管理費用人民幣174.4百萬元，同比增長21.8%，管理費用率6.9%，同比下降2.5個百分點，主要由於公司規模擴張，在不斷加強管理隊伍建設的同時管理人員人數增多，因此人員薪酬總數增加，但增長比例少於營收增長比例。

研發開支

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月研發開支的金額及佔收入的比重：

	截至6月30日止六個月				
	2026年		2025年		變動
	人民幣千元	佔收入比重	人民幣千元	佔收入比重	
	(未經審計)		(經審計)		
研發開支	<u>446,329</u>	<u>17.6%</u>	<u>361,282</u>	<u>23.7%</u>	<u>23.5%</u>

截至2026年6月30日止6個月本公司研發開支人民幣446.3百萬元，同比增長23.5%，研發開支費用率17.6%，同比下降6.1個百分點，主要由於公司始終堅持產品矩陣拓展與核心技術深耕，為了把握長期發展的窗口機會、吸引和保留核心人才、持續完善產品矩陣，為後續業務營業收入的增長夯實基礎，公司在研發投入、人才建設等多方面持續投入資源，研發開支總額增加，但增長比例小於營收增長比例。

其他淨收入

本公司其他收入由截至2025年6月30日止6個月的人民幣41.7百萬元增加至截至2026年6月30日止6個月的人民幣110.1百萬元，主要由於報告期內以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變動收益較上期增長所致。

財務成本

本公司財務成本由截至2025年6月30日止6個月的人民幣11.3百萬元增加至截至2026年6月30日止6個月的人民幣12.8百萬元，其中貸款費用由截至2025年6月30日止6個月的人民幣11.0百萬元增加至截至2026年6月30日止6個月的人民幣12.5百萬元，主要由於公司業務規模不斷擴大，營運資金需求更高所致。

期內盈利

本公司截至2026年6月30日止6個月的期內盈利為人民幣65.1百萬元，而截至2025年6月30日止6個月的期內虧損為人民幣78.0百萬元，由虧損轉為盈利，主要由於下游汽車電子、光伏與儲能、工業自動化、服務器電源等領域客戶需求快速增長，公司相關產品出貨量大幅提升；公司持續圍繞下游應用場景佈局產品研發，半導體產品及解決方案矩陣不斷豐富，可供銷售的產品型號持續增加，銷售規模穩步擴張；海外業務戰略拓展持續推進，海外客戶收入貢獻穩步提升，因此截至2026年6月30日止6個月的期內盈利金額大幅上升。

綜合財務狀況表

下表載列本公司2026年6月30日及2025年12月31日簡明綜合財務狀況表的絕對金額：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
非流動資產總額	4,583,472	3,503,922
流動資產總額	5,929,338	6,177,578
總資產	10,512,810	9,681,500
非流動負債總額	1,577,431	1,014,811
流動負債總額	1,174,114	1,051,926
總負債	2,751,545	2,066,737
流動資產淨值	4,755,224	5,125,652
資產淨值	7,761,265	7,614,763
股本	162,623	161,597
庫存股份	(215,010)	(127,664)
儲備	7,794,998	7,563,249
本公司權益股東應佔權益總額	7,742,611	7,597,182
非控股權益	18,654	17,581
權益總額	7,761,265	7,614,763

本公司非流動資產總額由2025年12月31日的人民幣3,503.9百萬元增加至2026年6月30日的人民幣4,583.5百萬元，主要由於物業、廠房及設備及長期應收的產能保證金增加所致。

本公司流動資產總額由2025年12月31日的人民幣6,177.6百萬元減少至2026年6月30日的人民幣5,929.3百萬元，主要由於以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產減少所致。

本公司非流動負債總額由2025年12月31日的人民幣1,014.8百萬元增加至2026年6月30日的人民幣1,577.4百萬元，主要由於計息借款增加所致。

本公司流動負債總額由2025年12月31日的人民幣1,051.9百萬元增加至2026年6月30日的人民幣1,174.1百萬元，主要由於貿易及其他應付款項、1年內還款的計息借款增加所致。

本公司資產淨值由2025年12月31日的人民幣7,614.8百萬元增加至2026年6月30日的人民幣7,761.3百萬元，主要由於報告期內行使超額配售選擇權發行股份所致。

綜合現金流量表

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月的現金流量表選定資料：

	截至6月30日止6個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(經審計)
經營活動所用現金淨額	(710,483)	(307,665)
投資活動(所用)／所得現金淨額	(50,102)	13,180
融資活動所得／(所用)現金淨額	<u>667,200</u>	<u>(7,347)</u>
現金及現金等價物減少淨額	(93,385)	(301,832)
於1月1日的現金及現金等價物	2,464,327	1,012,215
匯率變動影響	<u>(71,258)</u>	<u>2,584</u>
於6月30日的現金及現金等價物	<u><u>2,299,684</u></u>	<u><u>712,967</u></u>

截至2026年6月30日止6個月本公司經營活動所用的現金淨額為人民幣710.5百萬元，一方面，公司的銷售規模持續快速增長，購買商品、接受勞務支付的現金與銷售商品、提供勞務收到的現金均有較大增幅，因產能和備貨需要，購買商品、接受勞務支付的現金增長相對更快。另一方面，公司堅持以人為本，在人才建設方面持續資源投入，支付給職工及為職工支付的現金也相應增加。

截至2026年6月30日止6個月本公司投資活動所用的現金淨額為人民幣50.1百萬元，主要包括支付購買物業、廠房及設備的款項人民幣347.2百萬元，購買聯營公司支付的款項人民幣135.0百萬元；一部分被處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所得款項淨額人民幣405.7百萬元所抵銷。

截至2026年6月30日止6個月本公司融資活動產生的現金淨額為人民幣667.2百萬元，主要包括全球發售所得款項人民幣103.2百萬元、取得銀行貸款人民幣655.6百萬元以及支付回購股份款項人民幣87.3百萬元(包括交易佣金及其他費用)。

流動資金及財務資源

本公司保持充足的現金及現金等價物來維持資金的靈活性，公司的現金及現金等價物主要包括銀行及手頭現金、存放於銀行的活期存款及其他流動性高的短期投資，下表載列本公司2026年6月30日及2025年12月31日現金及現金等價物的絕對金額：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
銀行及手頭現金	2,299,119	2,378,379
於其他金融機構的存款	2,030	87,248
總計	<u>2,301,149</u>	<u>2,465,627</u>

本公司現金及現金等價物由2025年12月31日的人民幣2,465.6百萬元減少至2026年6月30日的人民幣2,301.1百萬元，主要由於公司銷售規模不斷擴張，生產經營所需的營運資金支出較多所致。

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
銀行貸款	1,581,271	967,049
其他借款	—	—
減：「計入流動負債」項下的金額	189,870	115,537
總計	1,391,401	851,512

本公司的流動借款由2025年12月31日的人民幣115.5百萬元增加至2026年6月30日的人民幣189.9百萬元，主要由於長期借款一年內到期的金額增大所致。

本公司非流動借款由2025年12月31日的人民幣851.5百萬元增加至2026年6月30日的人民幣1,391.4百萬元，主要由於公司業務發展較快，營運資金需求增加，增加銀行貸款所致。

本公司預計未來為公司運營提供資金可獲的融資不會發生重大變動。

本公司保持穩健的資本比率以支持業務，通過資產負債比率管理資產結構，下表載列本公司2026年6月30日及2025年12月31日資產／負債總額的金額及資產負債率：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
資產總額	10,512,810	9,681,500
負債總額	2,751,545	2,066,737
資產負債率	26.2%	21.3%

本公司資產負債率(定義為負債總額佔資產總額的比例)由2025年12月31日的21.3%增加至2026年6月30日的26.2%，主要由於公司報告期內增加了借款所致。

截至2026年6月30日，本公司流動總額中貨幣性資產佔比約39%，考慮到本公司可動用的財務資源，包括現金及現金等價物、可動用的銀行融資、經營活動產生的現金流量及全球發售的所得款項淨額，本公司擁有至少12個月的充足運營資金。

資本承諾

下表載列本公司2026年6月30日及2025年12月31日資本承諾的絕對金額：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
已訂約購買物業、廠房及設備	208,621	201,878

本公司2026年6月30日的資本承諾金額為人民幣208.6百萬元，主要是公司為滿足經營規模的快速增長，為保證產能而簽訂的長期資產採購協議。

資本開支

下表載列本公司截至2026年6月30日止6個月及截至2025年6月30日止6個月資本開支的絕對金額：

	截至6月30日止6個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審計)	2025年 人民幣千元 (經審計)
支付購買物業、廠房及設備以及無形資產的款項	347,233	144,376
收購子公司支付的現金淨額	20,058	60,176
購買聯營公司支付的款項	135,028	10,000
總計	<u>502,319</u>	<u>214,552</u>

本公司的資本開支包括支付購買物業、廠房及設備以及無形資產的款項、收購子公司支付的現金淨額及購買聯營公司支付的款項。本公司資本開支由截至2025年6月30日止6個月的人民幣214.6百萬元增加至截至2026年6月30日止6個月的人民幣502.3百萬元，主要由於本期支付購買物業、廠房及設備以及無形資產的款項增加人民幣202.9百萬元，報告期內下游汽車電子、光伏與儲能、工業自動化、服務器電源等領域客戶需求快速增長，公司加大資本投入以滿足產量需求所致。

本公司預期以我們的經營現金流量，以及自有或自籌資金為我們的未來資本開支提供資金。

或有負債

截至2026年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有負債(截至2025年12月31日：零)。

外匯風險

本公司於全球營運並面臨源自各種貨幣風險敞口的外匯風險。當未來商業交易或已確認資產及負債以我們附屬公司各自功能貨幣以外的貨幣計值時，便會產生外匯風險。於報告期內，本集團並無使用任何金融工具對沖外匯風險。

資產押記

截至2026年6月30日，本公司用於質押或抵押取得銀行借款的抵押物賬面淨值為人民幣1,213.5百萬元(截至2025年12月31日：人民幣1,222.7百萬元)，主要為房屋建築物以及股權。

除以上所披露者外，本集團於2026年6月30日並無其他重大資產抵押或押記。

資產負債表外安排

截至2026年6月30日，本公司並無訂立且預期不會訂立任何資產負債表外安排。

管理層討論與分析

一、報告期內公司所處行業情況

(1) 模擬芯片市場情況

1) 全球半導體市場情況

2026年上半年，全球半導體市場延續2025年的復甦態勢，在AI算力需求的驅動下持續增長。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)2026年發佈的春季預測報告，2026年全球半導體市場規模將達到1.51萬億美元，同比增長約90%，增速創歷史新高。其中存儲器同比增長約250%，邏輯芯片同比增長37%，微處理器同比增長20%，模擬芯片同比增長10%，分立器件同比增長8%，傳感器與光電子器件同比增長3%。

增長動力方面，除工業控制等傳統領域的穩定需求外，AI技術的持續迭代、自動駕駛和機器人的快速發展，進一步拉動了模擬芯片需求。尤其是AI服務器、汽車電子等場景對高性能模擬芯片的需求持續釋放，構成了模擬芯片規模擴張的核心支撐。

2) 國內半導體市場情況

根據海關總署數據，上半年我國集成電路出口1,772.8億美元，同比增長超過96%，出口額創半年度歷史新高，並接近2025年全年數值(2,020.4億美元)；出口數量同比增長7%至1,794.4億個，出口均價同比大幅提升。6月單月集成電路出口382.1億美元，在整體出口額中佔比近10%，為第一大類出口商品。

根據中商產業研究院統計數據，2025年中國模擬芯片市場規模約人民幣2,203億元，2026年預計將達到人民幣2,451億元。基於國產模擬芯片性能與可靠性的持續提升，國產替代進程已從消費電子領域快速邁向對可靠性要求更高的工業與汽車級市場。AI基礎設施、新能源汽車、智能終端、5G通信和機器人的快速發展，拉動了電源管理、信號鏈等模擬芯片的需求。特別是AI服務器和新能源汽車等領域的發展，進一步推動了電源管理集成電路等產品的需求增長，國內模擬芯片企業有望在國產替代加速的背景下進一步提升市場佔有率。

(2) 傳感器市場概況

根據中商產業研究院統計數據，2024年中國傳感器市場規模為人民幣4,061.2億元，較上年增長11.43%；2025年市場規模約人民幣4,525.3億元；2026年預計將達到人民幣5,042.4億元。

隨著新能源汽車、工業自動化、智能家居、低空經濟、健康監測、人形機器人等下游領域持續擴容，帶動磁傳感器、壓力傳感器、激光雷達等需求快速增長。汽車電子是高端傳感器國產替代的核心陣地，隨著L2級輔助駕駛滲透率提升及L3級自動駕駛政策試點推進，磁傳感器、壓力傳感器、激光雷達等需求將持續快速增長。

(3) 主要下游市場情況

1) 汽車電子

根據中國汽車工業協會統計數據，2026年上半年汽車產銷分別完成1,499.3萬輛和1,501.7萬輛，同比分別下降4%和4.1%；新能源汽車產銷分別完成743.8萬輛和744.6萬輛，同比分別增長6.7%和7.3%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的49.6%。2026年6月，新能源汽車產銷分別完成159.8萬輛和164.3萬輛，同比分別增長26%和23.6%。出口方面，上半年汽車累計出口509.6萬輛，同比增長65.3%；其中新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長1.2倍，佔整體汽車出口比例超過46%。

2024年，中國汽車模擬芯片的國產化率僅為5%，為了擺脫對進口模擬芯片的依賴，國內汽車品牌積極推動模擬芯片的國產化，以確保供應鏈的自主可控。另外，智能化已成為汽車產業核心發展趨勢。根據弗若斯特沙利文統計和預測，2024年智能新能源汽車模擬芯片單車價值已達人民幣1,500–2,800元，預計2029年將提升至人民幣2,200–4,000元。

工業和信息化部(「工信部」)數據顯示，2026年上半年，L2級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率達到70.5%，領航駕駛輔助(NOA)功能乘用車滲透率達到34.2%，首批L3級有條件自動駕駛車型已開始在特定區域上路通行。智能座艙與自動駕駛功能持續迭代，多傳感器融合方案彌補純視覺方案不足，帶動信號鏈與電源管理芯片需求增長。在智能駕駛領域，模擬芯片承擔雷達／攝像頭信號調理、傳感器融合及高壓系統隔離等關鍵功能，確保多模態數據實時處理。隨著L2級輔助駕駛滲透率提升及L3級自動駕駛政策試點推進，激光雷達、4D成像毫米波雷達等高端傳感器配套芯片需求將持續釋放。

2) 光伏及儲能

國家能源局統計數據顯示，截至2026年6月底，全國累計發電裝機容量40.4億千瓦，同比增長10.8%；其中太陽能發電裝機容量12.7億千瓦，同比增長15.8%；風電裝機容量6.8億千瓦，同比增長18.5%，上半年國內新增裝機72.07 GW，同比下滑約66%。中國光伏行業協會表示，2026年預計全球新增裝機612GW，2026–2030複合增長率為7%，2030年預計新增裝機升至864GW。

模擬芯片在光伏逆變器、儲能變流器等新能源核心設備中扮演關鍵角色。隨著光伏逆變器、儲能變流器向高效化、集成化、小型化方向持續升級，模擬芯片已從單一功能模塊向多維度異構融合架構深度演進，核心依託系統級封裝(SiP)技術，將驅動電路、採樣調理、數字接口及電源管理單元集成於單芯片，同時整合被動器件，大幅減少外圍器件數量，提升光伏設備系統可靠性。此外，集成化設計還可融入智能化感知功能，在芯片內部集成過溫、過流、過壓檢測模塊，實現故障實時監測與快速響應。

3) 工業自動化

工信部數據顯示，上半年裝備工業增加值同比增長6.4%，佔規模以上工業比重為20%，對規模以上工業增加值增長的貢獻率達23.5%；工業機器人、服務機器人產量同比分別增長28%和11.9%。

「AI+」相關產業增長持續拉動半導體、電子製造等高端領域的自動化設備需求，固態電池中試線與鋰電擴產亦將帶來新一輪設備投資週期。另外，以低空經濟、具身智能為代表的新質生產力發展，將為行業開闢全新增長空間。同時，工控出海將成為企業重要的長期增長極，國內領先企業正加速全球化佈局以貢獻業績增量。

4) AI服務器

根據Fortune Business Insights數據，2026年全球AI服務器市場規模預計將達到2,622.2億美元，2024–2034年複合年增長率34.73%，到2034年底有望突破28,473.2億美元。

AI服務器電源管理系統負責確保AI服務器的穩定電力供應，在PSU、UPS等一二級電源環節，隨著服務器電源功率和電壓持續提升，隔離電源、隔離採樣、隔離驅動承擔高低壓電氣隔離的安全防護，需求持續提升；在面向GPU/CPU核心供電的三級電源環節，多相控制器與DrMOS構成的多相DrMOS方案成為主流。此外，AI服務器需要ADC/DAC實現模擬與數字信號轉換，完成數據採集與輸出；以太網物理層芯片、光纖通信模塊負責信號放大、濾波與傳輸；隨著液冷技術快速普及，溫控傳感器、風扇驅動等模擬芯片需求持續增長。

5) 人形機器人

根據工信部數據，2025年我國人形機器人產量約為2萬台，2026年上半年已超過4萬台，預計全年將超過10萬台。

人形機器人對模擬芯片的需求分佈在電源管理、信號轉換和處理、通信接口、傳感器信號處理以及電機驅動和控制等多個核心領域。單台人形機器人需搭載數十顆磁傳感器、壓力傳感器、慣性測量單元(IMU)等。隨著人工智能、5G通信和物聯網技術的不斷進步，人形機器人正從技術驗證向商業化落地過渡，帶動仿生皮膚、各類傳感器、柔性材料等全新供應鏈生態逐步成型。

6) 消費電子

國務院新聞辦公室2026年上半年國民經濟運行數據顯示，包括智能眼鏡在內的可穿戴智能設備零售額增長超過1倍，高能效等級家電零售額增長超過30%。消費電子產品在5G化、智能化、可穿戴化方向上的持續升級，帶動了電源管理、音頻功放等模擬芯片單機價值量的提升與需求的增加。

二、報告期內公司從事的主要業務

(一) 主要業務情況

公司是一家高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司。公司以『「感知」「驅動」未來，共建綠色、智能、互聯互通的「芯」世界』為使命，堅持『可靠、可信賴、持續學習、堅持長期價值』企業價值觀，致力於為數字世界和現實世界的連接提供芯片級解決方案。

公司專注於圍繞下游應用場景組織產品開發，聚焦傳感器、信號鏈和電源管理三大產品方向，提供豐富的半導體產品及解決方案，並被廣泛應用於汽車、泛能源及消費電子領域。目前已能提供4,200餘款可供銷售的產品型號。

報告期內，公司主營業務未發生重大變化。

(二) 主要產品和服務情況

公司產品涵蓋傳感器、信號鏈和電源管理三大產品領域，被廣泛應用於汽車、泛能源及消費電子領域，其中泛能源領域主要是指圍繞能源系統的工業類應用，從發電端、到輸電、到配電、再到用電端的各個領域，包括光伏儲能、數字電源、工業控制、智能電網等。公司產品具體情況如下：



(1) 傳感器產品

公司傳感器產品主要包括磁傳感器、壓力傳感器、溫濕度傳感器，具體如下：

產品類型	主要產品	主要特點
磁傳感器	集成式電流傳感器、線性電流傳感器、輪速傳感器、角度傳感器，工業編碼器，開關與鎖存器，線性位置傳感器等	基於霍爾技術、AMR技術、TMR技術、BFC技術、VHS技術提供高精度的電流檢測、角度檢測、位置檢測等全品類的磁傳感器解決方案，可廣泛應用於汽車電子、工業控制、醫療電子、家電、消費等市場。
壓力傳感器	表壓傳感器、絕壓傳感器、差壓傳感器等	主要基於硅的壓阻效應並採用先進的MEMS微加工工藝，能夠實現寬溫度範圍下的微低壓壓力檢測(-100kPa到400kPa)，同時產品出廠的預校準能大幅簡化客戶系統設計，可廣泛應用於汽車電子、工業控制、醫療電子、白色家電等市場。
溫濕度傳感器	模擬輸出溫度傳感器、數字輸出溫度傳感器、溫濕度傳感器等	主要採用晶體管PN結溫度效應並集成高精度信號調理電路。其超高輸出精度和極低的功耗可廣泛應用於工業、醫療、便攜式設備、家用電器、可穿戴設備以及電腦、服務器等市場，同時豐富的封裝形式也可廣泛適用於多種環境與設備。

(2) 信號鏈產品

信號鏈芯片是系統中信號從輸入到輸出的路徑中使用的芯片，包括信號的收集、放大、傳輸和處理的全部過程，主要包括線性產品、隔離產品、轉換器產品、接口產品等。公司信號鏈產品涵蓋了信號鏈細分領域中的信號調理芯片、隔離器、接口、通用信號鏈、MCU等，具體如下：

產品類型	主要產品	主要特點
傳感器信號調理芯片	MEMS麥克風ASIC、熱電堆傳感器ASIC、PIR傳感器ASIC、壓力傳感器ASIC、磁傳感器ASIC等	信號調理芯片將公司自主設計的各個電路模塊集成至一顆芯片中，能夠實現傳感器信號的採樣、放大、模數轉換、傳感器校準、溫度補償及輸出信號調整等多項功能，性能和成本都得到了大幅優化，是傳感器系統的核心部件，被廣泛應用於汽車電子、工業自動化、智能家居、TWS耳機消費電子等場景。
隔離器系列	數字隔離器、隔離接口、隔離電源、隔離採樣等	基於CMOS工藝，通過電容耦合技術利用電容內部的電場變化來實現數字信號的傳輸。另外，公司在標準數字隔離芯片的基礎上，陸續開發出了超寬體隔離器、「隔離+」產品。「隔離+」產品集成了電源、接口等多類型的數字隔離芯片，能夠同時實現電源、接口隔離和信號隔離，具有高集成度、低成本、小型化等優勢，被廣泛應用於汽車電子、泛能源、消費電子等領域。

產品類型	主要產品	主要特點
接口	CAN/LIN接口、I ² C接口、SerDes接口等	接口芯片是基於通用和特定協議且具有通信功能的芯片，廣泛應用於電子系統之間的信號傳輸，可提高系統性能和可靠性。
通用信號鏈	電壓基準、放大器、數據轉換器等	以運放(包括通用運放，精密運放，電流放大器等)、通用的電壓基準、通用比較器、通用模擬開關、分立的ADC/DAC等為基礎的標準模擬信號鏈芯片。在工業、汽車等應用場合作為模擬電路的基礎元器件被廣泛使用。
MCU	實時控制MCU/DSP、通用MCU、嵌入式處理器MCU+	實時控制MCU/DSP通過高主頻高算力ARM內核加上自研的數學運算加速核，搭配為實時控制優化的專用外設，可提高系統控制的實時性；MCU+產品則強調模擬外設的高集成度和針對應用優化的專用性，由一個小的MCU內核集成電源、接口、電機驅動的功率和驅動級模擬電路或者傳感器的信號處理模擬前端電路，上述相關產品可應用於光伏儲能、電源模塊、伺服變頻、汽車電子、智能家居等場景。

(3) 電源管理產品

電源管理芯片是在電子設備系統中實現對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理職責的芯片，是電子設備中的關鍵器件，電源管理芯片同步於電子產品技術和應用領域升級，產品種類繁多。公司的電源管理產品主要包括柵極驅動、供電電源、LED驅動、電機驅動、音頻功放、功率路徑保護等，具體如下：

產品類型	主要產品	主要特點
柵極驅動	隔離驅動、非隔離驅動等	用來驅動MOSFET、IGBT、SiC、GaN等功率器件的芯片，能夠放大控制芯片(MCU)的邏輯信號，包括放大電壓幅度、增強電流輸出能力，以實現快速開啟和關斷功率器件。被廣泛應用在工業、通信、新能源汽車等不同領域的開關電源和電機控制設計中。
電機驅動	直流有刷電機驅動、繼電器與螺線管驅動、步進電機驅動等	用來驅動BDC、Stepper、Relay、Valve、BLDC等多種電機負載的芯片，能夠在控制芯片(MCU)的邏輯信號輸入下，開通或切換驅動輸出，以實現系統驅動多種電機負載按需求動作。被廣泛應用在工業，汽車等不同領域的電機控制設計中。
音頻功放	音頻功率放大器等	用來放大前級弱信號並驅動揚聲器發出聲音，主要為車規級中大功率D類音頻功放，支持負載短路、開路、過流等各種診斷與保護功能。

產品類型	主要產品	主要特點
功率器件	SiC二極管及MOSFET等	是電子系統中用於控制和轉換電能的核心元件，在中、高功率應用場景中發揮著至關重要的作用。碳化硅(SiC)材料因其固有的寬禁帶特性以及良好的導熱性能，使得基於該材料的功率器件在高效能量轉換、快速開關速度、高耐壓和低導通損耗方面表現出色。廣泛適用於新能源汽車、光伏、儲能系統等領域。
LED驅動	線性LED驅動、開關型LED驅動等	支持完整的診斷保護，並具有恒流精度高和散熱能力強等特點，主要應用於汽車尾燈、前燈、內飾氛圍燈等場景。
供電電源	DC-DC、LDO、電壓監控、SBC、PMIC等	圍繞汽車板級供電系統完整佈局，產品涵蓋一次側／二次側Buck/LDO/Boost等通用電源，及高集成的SBC/PMIC類定製化專用電源。
功率路徑保護	高低邊開關、電子保險絲等	適合驅動阻性、容性、感性等多種負載類型，並支持完整的診斷保護功能。主要應用於車身控制器、整車控制器、配電控制器、BMS等場景。

(三) 經營情況討論分析

公司專注主營業務發展，圍繞下游應用場景組織產品開發，聚焦傳感器、信號鏈和電源管理三大產品方向，提供豐富的半導體產品及解決方案，並被廣泛應用於汽車、泛能源及消費電子領域，目前已能提供4,200餘款。報告期內公司經營情況如下：

1、經營業績情況

截至2026年6月30日止6個月，公司實現營業收入人民幣2,540.4百萬元，同比增長66.7%；本期歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣67.6百萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損為人民幣47.9百萬元。具體情況如下：

從分季度數據來看，公司從一季度營收人民幣1,141.4百萬元到二季度營收人民幣1,399.1百萬元，已累計實現多季度的營收環比增長，整體經營業績處於快速增長態勢。營收的增長主要得益於：(1)需求端，受益於國內需求回暖及光儲／汽車出海加速、AI算力基建需求爆發等多重因素，下游汽車電子、服務器電源、光伏與儲能、工業自動化等領域客戶需求快速增長，公司相關產品出貨量大幅提升；(2)產品端，公司持續圍繞下游應用場景佈局產品研發，半導體產品及解決方案矩陣不斷豐富，可供銷售的產品型號持續增加，銷售規模穩步擴張；及(3)市場端，公司海外業務戰略拓展持續推進，海外客戶收入貢獻穩步提升。

2026年一季度，歸屬於上市公司股東的淨虧損、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損分別為人民幣3,573.7萬元和人民幣5,477.0萬元。2026年二季度，歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為人民幣10,332.8萬元和人民幣688.1萬元。歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤在2026年二季度轉正，主要得益於收入端與費用端的同步改善：(1)收入端，客戶需求的增長、產品矩陣的豐富和海外業務的持續拓展，帶動公司出貨量和營收實現大幅增長；及(2)費用端，公司持續深化精益管理與提升組織效率，使總費用佔營業收入的比例下降，進而推動了盈利能力的改善。

2、研發情況

公司始終堅持技術創新與研發投入，截至2026年6月30日止6個月研發費用為人民幣446.3百萬元，同比增長23.5%，主要係公司注重人才、技術積累，在研發投入、人才建設等多方面持續的資源投入，公司規模擴張，研發投入總額整體增加，其中主要為研發人員及其平均薪酬的增加所致。截至2026年6月30日，公司研發人員人數為704人，同比增長20%。截至2026年6月30日止6個月公司研發人員平均薪酬為人民幣44.3萬元／人，同比微漲0.9%。具體情況如下：

- (1) 傳感器產品。磁傳感器方向，基於電渦流感應原理並集成自研非線性自校準算法的高精度游標絕對值編碼器芯片已實現量產，基於雙碼道游標磁感應的絕對值角度編碼器芯片完成客戶送樣和驗證。第二代電感式接近開關傳感器完成終端驗證，通過多點數字溫度校準有效提升客戶生產效率；基於COT工藝的新一代霍爾傳感器完成流片。車載加速度傳感器方向，應用於底盤RNC的加速度傳感器，可實時監測路噪並反饋至座艙音頻系統實現降噪，研發進展順利。壓力傳感器方向，搭載可配置電池包熱失控算法的超低功耗壓力傳感器完成客戶送樣測試，可適配不同電池包客戶的差異化需求。
- (2) 信號鏈產品。公司隔離產品線可全面覆蓋從緊湊空間佈局到高壓採樣的全場景應用需求，持續迭代升級並推出多款全新產品，包括「小型化」的數字隔離器、新一代隔離CAN芯片、寬壓隔離電壓採樣芯片、車規級的全集成隔離電源芯片以及EMC優化的高壓固態繼電器芯片等；其中，新一代數字隔離器在工業和汽車市場已經實現大批量的出貨。公司接口產品線持續拓展汽車級產品佈局，推出了首款車載音頻接口總線芯片，滿足車廠的應用需求；在高速接口方向，車載視頻SerDes接口芯片進展順利。

在通用信號鏈方向，公司產品覆蓋通用運算放大器、電流採樣運算放大器、汽車專用MCU+模擬類產品，預計上述產品系列將在未來數年內逐步成為公司新的業務增長點。

公司MEMS麥克風ASIC產品線業務實現穩步增長，公司已在該細分領域逐步成長為行業內重要的市場參與者。後續公司將持續在更高信噪比、更低功耗的硅麥ASIC產品領域加大研發投入，進一步鞏固並提升市場競爭力。

在實時控制MCU方向，公司推出了集成EtherCAT從站控制器的三核同構M7內核的實時控制MCU，可廣泛應用於工業伺服、機器人關節等領域。報告期內，公司部分實時控制MCU產品已獲得ISO 26262的ASIL-B功能安全證書。

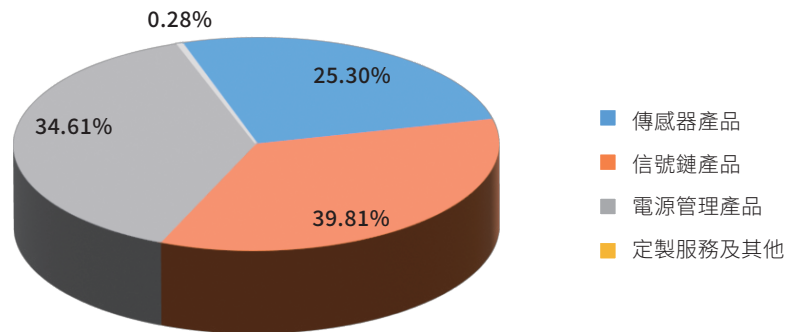
- (3) 電源管理產品。隔離柵極驅動方向，公司新一代專為SiC功率器件定製開發的單/雙通道隔離驅動產品陸續量產並迅速在汽車OBC、充電樁、光伏逆變器市場實現規模發貨。在第一代功能安全驅動規模發貨的同時，第二代功能安全隔離柵極驅動芯片開始主機廠送樣測試，並完成多個項目定點，持續鞏固公司在汽車主驅領域的市場份額與行業競爭力。非隔離柵極驅動方向，面向AI服務器電源應用的中低壓GaN驅動芯片已實現批量發貨，面向車用激光雷達的功率集成芯片完成關鍵客戶測試驗證，進一步擴展了GaN相關柵極驅動及功率集成產品矩陣。

電機驅動產品方向，公司第二代多路集成半橋驅動芯片開始量產交付。基於公司COT工藝開發的多路預驅芯片完成多個客戶測試導入及項目定點。大電流集成H橋驅動系列完成規模發貨，公司已基本完成車身控制系統中直流馬達驅動產品全覆蓋。音頻功放產品方向，首款4通道75W Class D音頻放大器新增多個客戶導入及項目定點。

在LED驅動方向，多通道產品集中上量發貨，與大客戶系統定制的產品已完成驗證導入；面向汽車前燈照明解決方案的Boost升壓芯片、恒流源降壓芯片及矩陣控制芯片已完成量產出貨，在多個頭部客戶已完成驗證導入。在供電電源方向，首款為ECU系統、MCU供電的SBC及首顆專為車載攝像頭設計的PMIC均已完成在行業國內外頭部客戶的導入和驗證。在功率路徑保護方向，針對下一代產品的單芯片工藝開發進展順利，高邊開關係列持續擴品，相關產品已實現大規模上量，市場份額持續提升。

報告期內，公司產品結構營收情況如下：

2026年半年度產品結構



3、市場應用情況

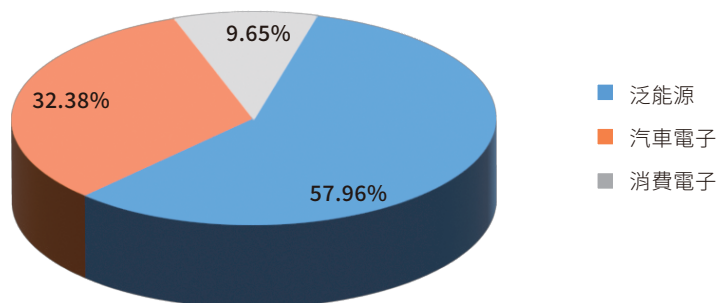
2026年上半年，新能源汽車產銷量分別為743.8萬輛和744.6萬輛，同比分別增長6.7%和7.3%，行業電動化、智能化趨勢持續深化，L2級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率已達70.5%，領航輔助駕駛功能滲透率達34.2%，800V高壓快充平台全面普及，驅動汽車電子領域業務保持快速增長。公司可為汽車提供系統化的解決方案，在新能源汽車三電、汽車照明、汽車電控、車身域控、燃油車動力系統、熱管理、智能座艙、底盤安全等領域提供涵蓋傳感器、信號鏈、電源管理等產品，包括數字隔離器、隔離驅動、隔離採樣、傳感器、LED驅動、通用接口、功率路徑保護、輪速傳感器、電機驅動、Class D音頻功放、實時控制MCU、車載SoC芯片、SerDes接口等。報告期內，公司在汽車電子領域出貨量已達5.34億顆，累計出貨量已超過19.52億顆。

在泛能源領域中，工控板塊伴隨製造業回暖穩健增長，6月製造業PMI為50.3%，連續4個月運行在擴張區間，二季度PMI均值在連續5個季度收縮後重回擴張區間，高技術製造業PMI達53.5%，工業自動化設備、電機驅動等需求持續恢復；光伏新能源領域上半年經歷深度調整，產業鏈各環節產品價格持續探底，行業進入加速去產能階段；電源模塊領域受益於AI服務器等下游需求拉動，公司可為服務器電源一二級電源PSU提供驅動、隔離芯片、MCU等產品，其中高壓GaN驅動芯片及中低壓GaN合封產品均已批量發貨，公司部分產品已在國內外服務器電源客戶中量產出貨；人形機器人領域，公司的磁編碼器可在靈巧手中實現精細動作控制，各類傳感器、電源產品、接口等可實現感知與通信功能，動力電池BMS系統亦可使用公司的電源產品、電流傳感器、溫度傳感器等；總體來看，泛能源市場呈現工控回暖、光伏承壓、AI電源強勁增長的結構性分化格局。

與此同時，消費電子市場持續復甦，其中智能手機、可穿戴設備、智能家居等帶動MEMS傳感器需求增長，3D打印、無人機和掃地機器人等市場均呈現高景氣度態勢。

從下游應用的收入結構來看，汽車電子領域收入佔比為32.38%，較上年同期佔比34.04%略有下降；泛能源領域收入佔比為57.96%，較上年同期佔比52.57%略有上升，主要係公司儲能、數字電源收入隨下游景氣度提升而快速增加；公司在消費電子領域的營收佔比為9.65%，較上年同期佔比13.38%略有下降。

2026年半年度下游應用佔比



4、 內部管理情況

報告期內，面對行業供應趨緊的環境，公司依託與供應商的長期合作保障交付需求，並堅持「深化戰略合作、長期協議鎖定、多元化佈局」的策略，為中長期業務增長奠定基礎。

供應鏈佈局方面，公司持續深化雙循環佈局。晶圓製造端，推動核心供應商擴產並簽訂長期產能協議，深化既有合作，同步引入新供應商，增強供應體系韌性；封裝測試端，以投資擴產與委外合作相結合，提前佈局測試產能並加大設備投入，保障產品驗證與批量交付銜接，優化代工成本與效率，緩解行業週期性波動影響。

平台技術研發方面，公司推進COT工藝平台建設，加快BCD車規工藝迭代，通過設計與工藝協同優化(DTCO)提升產品競爭力；加強供應商全生命週期管理，主要原材料國產化驗證有序推進，關鍵物料自主供應比例持續提高。

運營管理方面，公司優化矩陣式組織管理模式，依託採購專家團與工廠管理小組加強跨部門協同；推進供應鏈流程數字化轉型，完善S&OP及計劃體系，提升管理透明度與運營效率，支撐採購成本管控與資源優化配置。

體系認證方面，公司IATF16949支持場所認證於報告期內通過SGS首次年度監督審核，ISO 26262功能安全管理體系持續保持ASIL-D最高等級「Defined-Practiced」級有效運行。數字化質量管控方面，公司持續推進質量基礎設施數字化升級，其中有害物質管控系統、Lesson Learned經驗知識庫系統先後建成投用，IMC-MQ異常物料管理系統完成上線評審，RFMEA系統完成從專業版到企業版的全面升級。目前，公司已構建涵蓋質量管理、功能安全、環境管理、信息安全及實驗室能力等在內的五大體系的一體化質量管理框架，體系化車規交付保障能力持續增強。

5、人才建設情況

公司堅持以人為本，通過機制與文化的雙重驅動，激活組織內生動力，支撐長期戰略目標達成。報告期內，公司秉持「經營管理+領域專家」雙通道職業發展機制，打造契合業務戰略的多層次人才供應鏈，聚焦關鍵人才群體，實施從新人融入、骨幹挖掘到管理者轉身的全週期精準培養，健全專家評聘體系。報告期內，公司舉辦第九屆納芯微技術峰會，並常態化開展技術沙龍活動，為員工搭建技術交流與創新分享的平台，以人才驅動公司長期發展。

三、核心競爭力分析

1、核心技術及研發優勢

(1) 核心技術儲備豐富

公司作為集成電路設計企業，擁有專業的模擬芯片研發能力，並深度參與後續封裝框架和測試軟件的搭建，建立了從芯片定義到設計及交付的完整管控體系。憑藉多年的研發積累，公司以信號鏈技術為基礎，在模擬及混合信號領域開展了自主研發工作，並在傳感器、信號鏈、電源、驅動、第三代功率半導體等五大領域形成了多項核心技術，廣泛應用於各類自研模擬及混合信號芯片產品中，主要產品的核心技術指標達到或優於國際競品水平。

(2) 非標產品設計能力突出

為了滿足下游客戶的應用需求，公司可根據客戶的參數條件定製開發相應產品，如為客戶開發輪速傳感器、側邊氣囊壓力傳感器等傳感器類產品及低邊驅動等電源管理產品等，滿足下游汽車客戶不同的產品使用需求。此外，公司可應客戶的需求設計芯片、提供定製化封裝和測試方法，並深度參與到客戶的產品驗證、測試等工序的設計和搭建，為客戶提供從芯片設計、產品適配到批量標定校準等多環節服務。憑藉自身對行業的理解和技術積累，公司幫助多家下游客戶成功進入目標汽車廠商的合格供應體系。

2、 質量管控優勢

公司高度重視產品質量的可靠性，始終堅持高標準的質量要求。公司以「可靠可信賴」的質量方針為根本遵循，從產品的研發到生產的過程中，堅持嚴格的質量管控，為客戶提供穩定可靠的產品；以客戶滿意為宗旨，堅守對客戶的承諾，持續不斷的改進產品和服務，成為客戶可信賴的公司。公司秉承著「質量從設計開始並貫穿整個產品生命週期」的質量管理理念，構建了全面質量管理體系，並通過組織能力建設以及流程體系IT化建設確保全面質量管理體系的落實和執行，持續不斷地追求「零缺陷」的質量目標。在車規級產品領域，公司圍繞跨部門協同、車規級質量體系、車規標準下的產品設計開發、生產工藝控制及AEC-Q系列可靠性認證，建立覆蓋全生命週期的車規級質量管理體系，滿足車規級客戶的各項要求。

3、 產品品類優勢

經過多年的持續開發，公司可提供從信號採集到信號處理、傳輸的全鏈路產品，擁有從供電、驅動到功率路徑保護的產品矩陣，並覆蓋磁、壓力、溫濕度等多種傳感器產品，圍繞下游應用場景建立了豐富的產品品類，具有從消費級、工業級到車規級的產品覆蓋能力。公司持續研發，報告期內圍繞三大產品方向研發或推出了多款新品，傳感器方面，電渦流絕對值編碼器芯片、低功耗壓力傳感器等實現量產，磁感應角度編碼器、電池包熱失控壓力傳感器等完成送樣；信號鏈方面，新一代數字隔離器大批量出貨，車載SerDes接口芯片進展順利，推出了首款車載音頻接口總線芯片及M7內核的實時控制MCU；電源管理方面，SiC隔離驅動在汽車OBC、充電樁、光伏市場規模發貨，AI服務器GaN驅動批量出貨，第二代功能安全驅動、多路預驅芯片、ClassD音頻功放等完成客戶定點，SBC及PMIC已完成在行業國內外頭部客戶的導入和驗證。

4、 客戶資源優勢

憑藉過硬的技術研發實力以及優秀的產品口碑，公司取得了眾多行業龍頭標桿客戶的認可。此外，公司擁有豐富的面向汽車前裝市場模擬芯片、傳感器、專用MCU等產品定義、開發和量產經驗。相較其他領域公司來說，汽車客戶的認證週期長且測試嚴格，對產品的技術和質量要求更高，公司車規級芯片已在大量主流整車廠商／汽車一級供應商實現批量裝車。獲得行業標桿客戶的認證也有利於公司在相同領域客戶的商業拓展，進一步擴大領先優勢。

5、 供應鏈優勢

在晶圓製造方面，公司已與主要供應商保持長期、穩定的合作關係。在芯片封裝及測試方面，公司與主要封裝測試供應商深度合作多年，已形成了穩定的封裝測試工藝，併購入了專用測試設備交由部分測試廠商進行芯片測試，綁定了專屬產能。同時，隨著經營規模的快速增長，公司已自建封測工廠，將壓力傳感器及定製化產品自行封測，保證公司產能需求和控制成本，降低了行業產能波動對公司產品產量、供貨週期的影響。

四、公司未來發展的展望

公司發展戰略

公司專注於模擬及混合信號芯片的技術領域。未來，公司將繼續圍繞傳感器、信號鏈和電源管理三大產品方向，不斷突破產品發展的技術瓶頸，聚焦目標行業和頭部客戶持續應用創新，豐富產品品類，致力於成為泛能源和汽車電子領域佔據領導地位的完整芯片解決方案提供商。

2026年下半年經營重點

公司將繼續堅持長期價值主義經營理念，錨定「泛能源和汽車電子領域佔據領導地位的完整芯片解決方案提供商」的戰略目標，「以客戶為中心、以組織能力為根基」為核心主線，2026年下半年重點圍繞技術創新與工程能力升級、核心市場深耕與新領域拓展、全球化佈局、戰略供應鏈協同保障等關鍵方向重點發力，深化高價值賽道佈局，努力實現營業收入穩健增長、持續改善盈利能力。重點經營計劃如下：

一、加大前瞻性技術創新投入，強化工程能力建設

公司將推進先進實驗室與產品線協同的分層級預研機制建設，在電路設計平台、工程平台、系統應用平台三大技術體繫上持續深耕，鼓勵面向下一代或前瞻性產品的創新探索。同步推進設計工藝、封裝技術、測試方法等各環節前瞻性技術預研，持續攻堅下一代隔離工藝平台量產、車規BCD工藝平台迭代、磁傳感器工藝開發等關鍵技術，以技術創新驅動產品競爭力持續提升。同時，公司將持續強化封裝、測試、產品工程等後端工程能力建設，構建從設計到量產的全流程工程優勢，為產品研發與質量管控提供堅實支撐。通過測試篩查、量產數據分析與Top BIN分析等管控手段，持續挖掘工藝改進空間，穩步提升產品良率，系統性降低失效品流出風險，夯實質量口碑與客戶信任。

二、深耕核心市場根基，加快新領域戰略突破

公司將繼續深耕泛能源及汽車電子核心賽道，鞏固泛能源和汽車三電市場領先地位。在泛能源領域，公司將緊緊把握光伏儲能、工業自動化及AI服務器等下游需求復甦與高速增長機遇，持續擴大隔離、驅動、傳感器等優勢產品的市場份額，積極推進高性能電源芯片等新產品的市場拓展；在汽車電子領域，繼續聚焦新能源汽車三電系統等優勢應用，持續提升單車價值量，深化與各應用領域頭部客戶的聯合創新合作，推動公司由芯片供應商向系統級解決方案服務商轉型升級。尤其是在智能駕駛、智能座艙等新領域，加大產品合作投入，聚焦車載電源、域控制器、車載音頻、氛圍燈驅動等方向，構建梯次遞進的市場與業務組合，為長期可持續發展夯實基礎。

三、加速全球化佈局，提升海外市場份額

公司將依託A+H雙資本平台構建的全球化體系，將海外市場作為重點投入，繼續推進全球化市場佈局。在鞏固現有MNC客戶合作基礎的同時，加大海外銷售網絡佈局與本土化服務團隊建設，推動產品在國際頭部客戶中的滲透率提升。通過深度理解海外客戶的認證標準與供應鏈要求，加速關鍵產品線的海外資質獲取與量產導入。持續做強日本、韓國、德國等海外據點建設，按需完善區域佈局，構建本地化銷售、技術支持與客戶服務體系，全面提升海外市場響應效率與綜合服務能力。

四、深化戰略供應鏈協同，保障長期產能供給

公司將繼續聚焦供應鏈敏捷性、安全性與可持續性，與戰略供應商開展深度協同合作，從產能規劃、工藝共研到供應優先級，建立全方位戰略合作關係。繼續通過長單鎖定、工藝創新共建、專線建設等方式，確保在公司業務高速增長階段獲得穩定、充足的產能支持。公司將以戰略前瞻性與運營韌性為核心導向，通過精細化運營、前置產能規劃及動態庫存策略，獲得面向未來增長的長期、充足的產能保障，有力支撐業務規模的持續快速爬升與市場拓展。

購回、贖回或出售本公司上市證券

截至2026年6月30日止6個月，本公司在上海證券交易所購回合共521,686股A股並以庫存股份持有(「**所購回股份**」)，總代價為人民幣87,336,043.66元(不含佣金及其他費用)。進行回購乃旨在未來適宜時機全部用於員工持股計劃或股權激勵。所購回股份的詳情如下：

購回日期	所購回 股份數目	已付每股價格		
		最高價 人民幣元	最低價 人民幣元	總代價 人民幣元
2026年1月5日	256,441	163.20	160.20	41,424,481.88
2026年1月12日	175,488	175.39	172.88	30,510,585.45
2026年1月13日	89,757	172.99	169.94	15,400,976.33
總計	521,686			87,336,043.66

於2026年6月30日，本公司持有1,373,858股A股庫存股份，並擬於未來適當時機全部用於員工持股計劃或股權激勵。

除上文所披露者外，本公司及其任何附屬公司於報告期內並無購回、贖回或出售本公司任何上市證券(包括出售或轉讓任何庫存股份)。

發行股份

於2025年12月8日，公司發行19,068,400股H股股份並在香港聯交所主板掛牌上市，每股發行價格116.00港元。其後，公司於2026年1月2日超額配售發行1,026,600股H股股份，每股發行價格116.00港元。公司本次發行H股合計20,095,000股所得款項淨額(扣除因發行新股直接產生的發行費用後)為2,210.8百萬港元(約為人民幣2,010.1百萬元，每股可得淨額約為人民幣100.0元)。截至本公告日期，於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的所得款項淨額擬定用途概無變動。有關所得款項用途明細的詳情，請參閱將適時刊發的2026年中期報告。

除上文所披露者外，公司於報告期內並無發行其他股份。

重大投資以及有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售

報告期內，本公司對本公司的合營企業蘇州遠芯合智管理諮詢合夥企業(有限合夥)已追加人民幣100百萬元的投資，對本公司的聯營企業芯弦半導體(蘇州)有限公司已追加約人民幣87.57百萬元的投資。以上投資不構成《香港上市規則》第14章所定義之須予公布的交易。

報告期內，本公司並無持有重大投資、亦無進行有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

股息

截至2026年6月30日止6個月，本公司概無派付或擬派股息(截至2025年6月30日止6個月：無)。

期後事項

於2026年7月23日，本公司向528名員工授予464,953股A股第二類限制性股份，授予價格為每股人民幣139.87元。同日，本公司向63名員工及9名服務提供商授予859,226股H股獎勵，授予價格為每股72.60港元。本中期財務報告就此並無作出任何調整。

除上文所披露者外，自報告期末以來本公司並無其他重大期後事項。

審計委員會

於本公告日期，審計委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，即杜琳琳女士、張利民博士及 Qunwen Leng (冷群文) 博士，由杜琳琳女士擔任審計委員會主席。審計委員會已與管理層檢討本集團所採用之會計原則及慣例，並討論財務報告事項包括審閱本集團截至2026年6月30日止6個月之簡明綜合中期財務報表，並討論有關風險管理、內部監控事項，並無異議。此中期業績公告以本公司經與本公司核數師畢馬威會計師事務所協議同意的截至2026年6月30日止6個月之簡明綜合財務報表為基準。

企業管治常規

本公司致力達致高水平的企業管治標準。

董事會認為，高水平的企業管治標準對於為本集團提供一個以保障股東利益、提升企業價值、制定業務戰略和政策以及提高透明度的框架至關重要。

本公司已採納《香港上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》的守則條文作為本公司企業管治常規的基準。董事會認為，截至2026年6月30日止6個月，除下文所披露者外，本公司已遵守《企業管治守則》所載的所有適用守則條文。

根據《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條，董事長與行政總裁的職責應有區分且不應由一人同時兼任。我們並無分立的董事長及總經理，王升楊先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，鑒於其經驗、個人履歷及對業務營運的瞭解，王升楊先生為識別戰略機會的最適合董事，故由王升楊先生兼任董事長及總經理可促進戰略舉措的有效執行並有助於管理層與董事會之間的信息傳遞順暢。董事會認為，以同一人兼任董事長及總經理，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更有效力和效率的整體戰略規劃。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員(包括相關董事委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後於適當時機，將本公司董事長與總經理之職務分開。

董事遵守進行證券交易的標準守則

本公司已採納《香港上市規則》附錄C3所載的《標準守則》作為董事進行證券交易的守則。

經向全體董事作出具體查詢後，董事均確認彼等於截至2026年6月30日止6個月已遵守《標準守則》。

本公司已制定不遜於《標準守則》的《信息披露管理制度》及《內幕信息知情人登記管理制度》(統稱，「**信息披露管理規章**」)，以供因職位或受僱而可能擁有關於本公司或其證券的內幕消息的僱員進行證券交易。據董事所深知，於截至2026年6月30日止6個月，並無知悉任何僱員違反信息披露管理規章的事件。

刊發中期業績及H股2026年中期報告

本業績公告於本公司網站(www.novosns.com)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊載。本公司截至2026年6月30日止6個月的H股中期報告將適時於本公司網站及香港聯交所網站刊載以供查閱，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

釋義

在本公告中，除非文意另有所指，下列詞語或詞組具有如下含義：

「A股」	指	每股面值人民幣1.00元的本公司內資股，於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「《企業管治守則》」	指	《香港上市規則》附錄C1《企業管治守則》
「中國」	指	中華人民共和國
「公司」、「本公司」或「我們」	指	蘇州納芯微電子股份有限公司，一間於2013年5月17日在中國成立的公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：688052)，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：2676)
「董事」	指	本公司董事
「境內」或「國內」	指	中國大陸(僅就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣地區)
「全球發售」	指	本公司提呈發售H股以供認購，其詳情載於招股章程

「集團」或「本集團」	指	本公司及併表範圍內的子公司(附屬公司)
「H股」	指	每股面值人民幣1.00元的本公司境外上市外資普通股，於香港聯交所上市並以港元交易
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯交所證券上市規則》
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的標準、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「《標準守則》」	指	《香港上市規則》附錄C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「招股章程」	指	本公司日期為2025年11月28日有關全球發售的招股章程
「報告期」或「本期」	指	2026年1月1日至2026年6月30日
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股

「股東」	指	股份持有人
「同比」	指	與上年同期比較
「%」	指	百分比

技術詞彙表

於本公告內，除非文義另有所指，否則本文件所用有關本公司及其業務的若干詞彙的解釋及釋義具有下文所載涵義。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「ADC」	指	模擬數字轉換器，用於將連續的模擬信號轉換為離散的數字信號的裝置
「AEC-Q」	指	汽車電子委員會制定的標準
「模擬」	指	模擬信號，隨某一隨時間變化參數而連續且無限變化的電壓、電流或物理量
「車規級」	指	車規級芯片是指經過專門設計、製造及鑒定以滿足汽車行業嚴格要求及標準的芯片
「BMS」	指	電池管理系統
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CAN」	指	控制器區域網絡，一種通訊協議
「CMOS」	指	互補式金屬氧化物半導體
「DAC」	指	數字模擬轉換器，用於將數字信號轉換為模擬信號的裝置
「DC」	指	直流電
「數字」	指	以離散數值序列表示數據的信號

「fabless」	指	實體專注於芯片研發與設計，並將製造外包給第三方的商業模式
「GaN」	指	氮化鎵，一種二元III/V族直接帶隙半導體，適用於高功率且可在高溫下運作的電晶體
「霍爾效應」	指	當磁場垂直於導體內電流時，在導體兩側產生電壓差的現象，為多種磁感測技術的基礎
「芯片」或「集成電路」	指	在一小片半導體材料(晶片)上的一組電子電路
「I ² C」	指	同步式多主控／多從屬單端串列通訊協議
「IGBT」	指	絕緣柵雙極型電晶體，三端功率半導體元件，主要作為電子開關
「LDO」	指	低壓差線性穩壓器，可在極小輸入輸出電壓差下運作的穩壓器
「LED」	指	發光二極體，通電時會發光的半導體二極體，廣泛應用於電子設備
「LIN」	指	用於現代車輛部件間通訊的網絡協議
「MCU」	指	微控制器單元，包含通用處理器核心、輸入／輸出接口及多功能模組的芯片
「MEMS」	指	微機電系統，由尺寸介於1至100微米元件構成的微型裝置技術
「MOSFET」	指	金屬氧化物半導體場效電晶體，用於放大或切換電子信號的電晶體類型

「運放」	指	接收差分電壓輸入並產生單端電壓輸出的模擬電路模組
「光伏」	指	光伏
「研發」	指	研究與開發
「傳感器」	指	測量或偵測現實世界狀況(如動作、熱力或光線)，並將狀況轉換為模擬或數字表示的裝置
「SiC」	指	碳化硅，一種用於多種電子應用的半導體材料
「V」	指	伏特，電壓單位
「VHS」	指	垂直霍爾傳感器，一種優化用於偵測垂直磁場的霍爾傳感器結構

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年8月27日

於本公告日期，董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生及張帥先生；及(iii)獨立非執行董事杜琳琳女士、張利民博士及Qunwen Leng (冷群文) 博士。